

Kleje przewodzące						
Typ kleju	PC 300x	PC 320x	PC 322x	PC 323x	PC 343x	PC 360x*
Sitodruk	+	+	+	+		+
Drukowanie szablonowe	+	+	+	+		+
Dozowanie	+	+	+	+	+	+
Warunki utwardzania i główne cechy						
Utwardzanie od 80 ⁰ do 120 ⁰ C	○				○	+
Utwardzanie od 120 ⁰ do 180 ⁰ C	+	+	+	+	+	
Szybkie utwardzanie (np. 60s w 120 ⁰ C)						+
Szybkie utwardzanie (np. 60s w 180 ⁰ C)		+	+	+		
Dobra adhezja	+			+		
Dobra stabilność termiczna	+ ¹⁾		+ ¹⁾	+ ²⁾		
Przewodność cieplna	+	++	+	+	+	
Substraty						
Ołów	○	○	○	+		○
Ceramika	+		○	+	+	○
PCB	+	○	+	○	+	+
Elastyczne	+	+	○	○	+	+

Uwagi:

* =w przygotowaniu,

+ =rekomendowane,

○ = możliwe,

1) do 150⁰C,

2) do 180⁰C, + = minimum 5 W/mK, ++ = minimum 6 W/mK